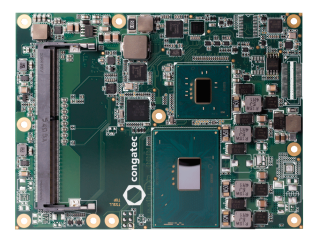
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.es](http://www.congatec.es) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**** *Módulos servidor: nuevos módulos COM Express Basic de congatec con los últimos procesadores Intel® Core ™ e Intel® Xeon®, que ofrecen un rendimiento integrado a nivel de servidor*

*Texto y foto también disponible online en::* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

Nota de prensa

congatec presenta módulos servidor con los nuevos   
procesadores Intel® Xeon® / Core™

**Los nuevos módulos COM Express de congatec ofrecen un rendimiento integrado a nivel de servidor**

**Deggendorf, Alemania, 29 de Octubre de 2015 \* \* \*** congatec AG, una empresa líder en tecnología de módulos CPU embebidos, ordenadores monoplaca (SBC) y diseño integrado y servicios de fabricación (EDM), ha ampliado su cartera de módulos COM Express Basic con una nueva gama de módulos embebidos a nivel de servidor. Los nuevos módulos servidor están equipados con la sexta generación de procesadores Intel® Xeon® e Intel® Core™ i3/i5/i7 (con nombre en código Skylake). La memoria DDR4 de los módulos conga-TS170 proporciona hasta el doble de rendimiento de la memoria del sistema para aplicaciones intensivas de datos, mientras que consume un 20 por ciento menos de energía y requiere sólo la mitad de la huella de memoria RAM DDR3, que se espera se deje de usar en futuras aplicaciones. Además, los módulos ofrecen una mayor velocidad de procesador, un bus de sistema acelerado un 60 por ciento, e Intel® Smart Cache ampliada (hasta 8 MB), así como el soporte PCIe Gen 3.0 para todos los buses PCIe y el nuevo Intel® HD Graphics P530. En general, los usuarios pueden esperar beneficiarse de un rendimiento del sistema y densidad de envolvente mejorados, con requisitos de espacio y consumo más bajos.

Los nuevos módulos se han desarrollado para diseños integrados a nivel de servidor, que operan dentro de un rango de potencia total disipada de TDP de 25-45 W y requieren interfaces E/S e IoT personalizadas. Los nuevos módulos conga-TS170 equipados con procesadores Intel Core son adecuados para aplicaciones que incluyen equipos de prueba y medición, sistemas back-end para visualización de imágenes médicas, estaciones de carga de trabajo industriales de alto rendimiento, así como máquinas expendedoras inteligentes.

Las variantes del módulo Intel® Xeon® proporcionan, además la protección de memoria ECC, que amplían su uso a las aplicaciones de servidores de datos críticos y de puerta de enlace. Este tipo de aplicaciones se pueden encontrar en servidores industriales IoT y en la nube, con analítica de grandes bases de datos, servidores de nodos de borde tipo carrier, así como en servidores de automatización de conectividad Industria 4.0, que albergan múltiples máquinas virtuales o servidores de medios con flujo múltiple de transcodificación de vídeo en tiempo real.

Además, los nuevos módulos conga-TS170 ofrecen potentes herramientas para gestionar aplicaciones IoT distribuidas, M2M e Industria 4.0. Gracias a la tecnología Intel® vPro y el controlador congatec de gestión de la placa, con temporizador de vigilancia y control de pérdidas de energía, los módulos están completamente equipados para el control remoto, tareas de gestión y mantenimiento, hasta la gestión fuera de banda.

Para aplicaciones sensibles al coste que no necesariamente requieren una gestión compleja fuera de banda o de virtualización, también están disponibles los módulos basados ​​en el procesador Intel® Core ™ i3 y el chipset Intel® HM170.

El conjunto de características al detalle

Los nuevos módulos de conga-TS170 están equipados con lo último en procesadores, la sexta generación v5 Xeon® de 14nm e Intel® Core™. Cuentan con un TDP de 25-45 W, hasta 8 MB de caché inteligente y memoria súper rápida 2133 DDR4 de hasta 32 GB, implementada como memoria ECC para aplicaciones de seguridad críticas en las variantes Intel® Xeon. Para un funcionamiento eficiente de consumo 24/7, los nuevos módulos soportan modo standby desconectado, en lugar del antiguo modo S3. Con el modo standby desconectado, el cambio del modo de reposo con ahorro de energía, al modo de rendimiento completo, tarda menos de medio segundo; como resultado, los sistemas pueden entrar en modo reposo con más frecuencia, sin afectar a la facilidad de uso y a la capacidad de respuesta.

La novena generación integrada Intel® HD Graphics 530 es compatible con DirectX 12 para gráficos 3D más rápido basados en Windows 10, soportando un máximo de 3 pantallas independientes 4K (3840 x 1260) a través de HDMI 1.4, DVI o DisplayPort 1.2. Para aplicaciones antiguas, hay disponible una salida LVDS de doble canal y VGA opcional. Gracias al soporte de hardware para la decodificación, así como la codificación de HEVC, VP8, VP9 y VDENC, ahora es posible transmitir vídeo de alta definición, de forma energéticamente eficiente, en ambas direcciones.

Además de gráficos PCI Express Gen 3.0 (PEG), la elección de interfaces E/S disponibles, incluye 8 buses PCI Express Gen 3.0, 4x USB 3.0, 8x USB 2.0, LPC y I²C. Los dispositivos de almacenamiento masivo SSD, HDD y BluRay se pueden conectar a través de 4x SATA 3.0, incluyendo soporte RAID 0, 1, 5, 10. Todos los sistemas operativos Linux y Microsoft Windows son soportados, incluyendo Windows 10. Completa la oferta un completo conjunto de complementos para facilitar el diseño, tales como soluciones de refrigeración, placas de soporte y kits de evaluación.

**Variantes de procesador:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesador** |  | | **Núcleos** | | |  | | **Smart Cache [MB]** | |  | | **Frecuencia [GHz]** | |  | | **Turbo Boost [GHz]** | |  | | **TDP [W]** | |  | | **Gráficos** |
| **Intel Core  i7-6820EQ** | |  | | **4** |  | | **8** | |  | | **2.8** | |  | | **3.5** | |  | | **45** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Core  i7-6822EQ** | |  | | **4** |  | | **8** | |  | | **2.0** | |  | | **2.8** | |  | | **25** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Core  i5-6440EQ** | |  | | **4** |  | | **6** | |  | | **2.7** | |  | | **3.4** | |  | | **45** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Core  i5-6442EQ** | |  | | **4** |  | | **6** | |  | | **1.9** | |  | | **2.7** | |  | | **25** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Core  i3-6100E** | |  | | **2** |  | | **3** | |  | | **2.7** | |  | | **-** | |  | | **35** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Core  i3-6102E** | |  | | **2** |  | | **3** | |  | | **1.9** | |  | | **-** | |  | | **25** | |  | | **Intel HD Graphics 530** | |
| **Intel Xeon  E3-1505M v5** | |  | | **4** |  | | **8** | |  | | **2.8** | |  | | **3.7** | |  | | **45 / 35** | |  | | **Intel HD Graphics P530** | |
| **Intel Xeon  E3-1505L v5** | |  | | **4** |  | | **8** | |  | | **2.0** | |  | | **2.8** | |  | | **25** | |  | | **Intel HD Graphics P530** | |
| **Intel® Core™  i7-6820EQ** |  | | **4** | | |  | | **8** | |  | | **2.8** | |  | | **3.5** | |  | | **45** | |  | | **Intel® HD Graphics 530** |

Hay disponible una hoja de datos con información adicional sobre los nuevos módulos conga-TS170 en: <http://www.congatec.com/products/com-express-type6/conga-ts170.html>.

**Acerca de congatec AG**congatec AG, con sede central en Deggendorf (Alemania), es un proveedor líder de módulos CPU industriales basados en los factores de forma estándar Qseven, COM Express, XTX y ETX, así como de SBCs y servicios EDM. Los productos de esta empresa cubren múltiples aplicaciones y se utilizan, por ejemplo, en las áreas de automatización industrial, tecnología médica, suministros para el sector del automóvil, aeronáutica y transporte. Sus áreas de conocimiento técnico incluyen funcionalidades BIOS extendidas de características únicas, junto con amplios paquetes de soporte de placa y controladores. Desde la fase inicial de diseño, los clientes reciben un apoyo adecuado a través de una gestión integral del ciclo de vida del producto. Los productos son fabricados por proveedores especializados, de acuerdo con las más altas normas de calidad. En la actualidad congatec cuenta con 177 empleados y con oficinas en Taiwán, Japón, China, Estados Unidos, Australia y la República Checa. Para obtener más información, consulte en [www.congatec.com](http://www.congatec.com/h) o a través de [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec/h), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG/h) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE/h).

\* \* \*

*Intel and Intel Xeon, Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*